





Title of Change:	Backend Assembly and Final Test site change for AR1011	
Proposed First Ship date:	22 April 2019	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <geethakrishnan.narasimhan@onsemi.com>	
Samples:	Samples will be available after completion of qualification. Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN for this change.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. IPCNs are typically issued 30 days prior to the issuance of the Final Change Notice (FPCN). An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	The changed parts will be identified with a different marking on the package and date code. The change in marking is described in "Description and Purpose". Date code for the changed parts will be updated in the FPCN document. There will be no change to the part number.	
Change Category:	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input checked="" type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____	
Change Sub-Category(s):	<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input checked="" type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input checked="" type="checkbox"/> Product specific change <input checked="" type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: Mountain Top (Pennsylvania, USA)	External Foundry/Subcon Sites: Rochester (New York State, USA)
Description and Purpose:		
The current backend assembly site at Shinko, Japan for AR1011 has issued an EOL (End of Life) with intent to not support beyond June 30, 2019. Therefore, the backend assembly process is being transferred and qualified at the following sites or locations. <ul style="list-style-type: none"> a) Backgrinding at Mountain Top, Pennsylvania, USA. b) Assembly and final test at Rochester, New York, USA. Detailed changes for the above process steps are described below:		
Backgrinding Change	Before Change Description (Shinko, Japan)	After Change Description Pennsylvania, USA
Backgrinding Tool	Shinko	Disco DFG 8540
Assembly changes	Before Change Description Shinko, Japan	After Change Description Rochester, New York
Die Attach	Henkel GA2W	Ablebond 967-1
Bond Wire	BW Nippon 99.99 Au 0.9mil	CCC 1.0mil Gold CC151-1A3752B
Assembly Site	Shinko	Rochester
Other Changes (Glass Attach)	G/A Epoxy: Kyoritsu WorldRock 5920G20	G/A Epoxy: Kyoritsu WorldRock 8724R4
*No change to the supplier or material for substrate and glass.		



Product Marking changes	From Shinko, Japan	To Rochester, New York
Product marking change		

Test Platform and Site Change:	From (Shinko, Japan)	To (Rochester, New York)
Test Platform	Shinko (proprietary)	IP750EX

Qualification Plan:

Qualification Vehicle: AR1011HSSC00SHAA0-DP

Test	Specification	Condition	Interval
PC	J-STD-020	30°C/60%RH for 96hrs + 3X IR Reflow	-
TC	JESD22-A104	-55°C - 125°C	500 cycles
HTSL	JESD22-A103	@ 150°C	504 hrs
THS	JESD22-A110	60°C/90%RH no bias	504/1008 hrs
WBS	AEC-Q100-001	-	-
WBP	Mil-Std-883 Meth 2011	-	-
SD	J-STD-002or JESD22 B102	-	-
MS	JESD22 B104	-	-
VFV	JESD22 B103	-	-
TEST	Test program to supplier data sheet or user specification	Pre- and Post-Stress Function/Parameter to meet datasheet or user specification	-

Estimated date for qualification completion: 30 March 2019

List of Affected Parts:

Part Number	Qualification Vehicle
AR1011HSSC00SHAA0-DP	AR1011HSSC00SHAA0-DP

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。



Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



変更件名:	AR1011 のバックエンド組み立ておよび最終テスト拠点の移管																						
初回出荷予定日:	22 April 2019																						
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <geethakrishnan.narasimhan@onsemi.com> にお問い合わせください。																						
サンプル:	サンプルの提供は認定完了後に開始されます。 現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。																						
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、通常、最終変更通知 (FPCN) の発行の 30 日前に発行されます。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がございましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。																						
変更部品の識別:	変更された製品は、異なる捺印と日付コードで識別されます。捺印の変更については「説明および目的」の項で説明しています。変更後品の日付コードは FPCN で更新されます。製品番号に変更はありません。																						
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input checked="" type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他																						
変更サブカテゴリ:	<input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input checked="" type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他:																						
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: マウンテントップ (米国ペンシルバニア州)	外部製造工場 / 下請業者拠点: ロチェスター (米国ニューヨーク州)																					
説明および目的:	<p>AR1011 についての現在のバックエンド組み立て拠点であるシンコー (日本) は製造中止 (End Of Life) を発表しており、2019 年 6 月 30 日以降はサポートされません。そのため、バックエンド組み立てプロセスを移管することになり、次の拠点またはロケーションの認定を開始します。</p> <p>a) 裏面研磨: マウンテントップ (米国ペンシルバニア州) b) 組み立ておよび最終テスト: ロチェスター (米国ニューヨーク州)</p> <p>上述のプロセス手順の詳細な変更は、以下のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>裏面研磨の変更</th> <th>変更前の表記 (シンコー、日本)</th> <th>変更後の表記 ペンシルバニア (米国)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>裏面研磨装置</td> <td>シンコー</td> <td>Disco DFG 8540</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>組み立ての変更</th> <th>変更前の表記 シンコー、日本</th> <th>変更後の表記 ロチェスター、ニューヨーク</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダイ接着剤</td> <td>Henkel GA2W</td> <td>Ablebond 967-1</td> </tr> <tr> <td>ボンド・ワイヤ</td> <td>BW Nippon 99.99 Au 0.9mil</td> <td>CCC 1.0mil Gold CC151-1A3752B</td> </tr> <tr> <td>組み立て拠点</td> <td>シンコー</td> <td>ロチェスター</td> </tr> <tr> <td>その他の変更 (ガラス接着剤)</td> <td>G/A エポキシ: Kyoritsu WorldRock 5920G20</td> <td>G/A エポキシ: Kyoritsu WorldRock 8724R4</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 回路基板およびガラスのサプライヤまたは材料に変更はありません。</p>		裏面研磨の変更	変更前の表記 (シンコー、日本)	変更後の表記 ペンシルバニア (米国)	裏面研磨装置	シンコー	Disco DFG 8540	組み立ての変更	変更前の表記 シンコー、日本	変更後の表記 ロチェスター、ニューヨーク	ダイ接着剤	Henkel GA2W	Ablebond 967-1	ボンド・ワイヤ	BW Nippon 99.99 Au 0.9mil	CCC 1.0mil Gold CC151-1A3752B	組み立て拠点	シンコー	ロチェスター	その他の変更 (ガラス接着剤)	G/A エポキシ: Kyoritsu WorldRock 5920G20	G/A エポキシ: Kyoritsu WorldRock 8724R4
裏面研磨の変更	変更前の表記 (シンコー、日本)	変更後の表記 ペンシルバニア (米国)																					
裏面研磨装置	シンコー	Disco DFG 8540																					
組み立ての変更	変更前の表記 シンコー、日本	変更後の表記 ロチェスター、ニューヨーク																					
ダイ接着剤	Henkel GA2W	Ablebond 967-1																					
ボンド・ワイヤ	BW Nippon 99.99 Au 0.9mil	CCC 1.0mil Gold CC151-1A3752B																					
組み立て拠点	シンコー	ロチェスター																					
その他の変更 (ガラス接着剤)	G/A エポキシ: Kyoritsu WorldRock 5920G20	G/A エポキシ: Kyoritsu WorldRock 8724R4																					



製品表示の変更	変更前 シンコー、日本	変更後 ロチェスター、ニューヨーク	
製品表示の変更			
テストプラットフォームおよび拠点の変更:	変更前 (シンコー、日本)	変更後 (ロチェスター、ニューヨーク)	
テストプラットフォーム	シンコー (自社装置)	IP750EX	
認定計画:			
認定試験用ピークル: AR1011HSSC00SHAA0-DP			
テスト	仕様	条件	間隔
PC	J-STD-020	30°C/60%RH for 96hrs + 3X IR Reflow	-
TC	JESD22-A104	-55°C - 125°C	500 cycles
HTSL	JESD22-A103	@ 150°C	504 hrs
THS	JESD22-A110	60°C/90%RH no bias	504/1008 hrs
WBS	AEC-Q100-001	-	-
WBP	Mil-Std-883 Meth 2011	-	-
SD	J-STD-002or JESD22 B102	-	-
MS	JESD22 B104	-	-
VFV	JESD22 B103	-	-
テスト	サプライヤデータに対するテストプログラムシートまたはユーザー仕様	データシートまたはユーザー仕様を満たすための前後の応力関数/パラメータ -	-
認定完了予定日: 2019/03/30			
影響を受ける部品の一覧:			
部品番号	認定試験用ピークル		
AR1011HSSC00SHAA0-DP	AR1011HSSC00SHAA0-DP		



KEY

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle
AR1011HSSC00SHAA0-DP		AR1011HSSC00SHAA0-DP